

# 46-7352 Economy Version

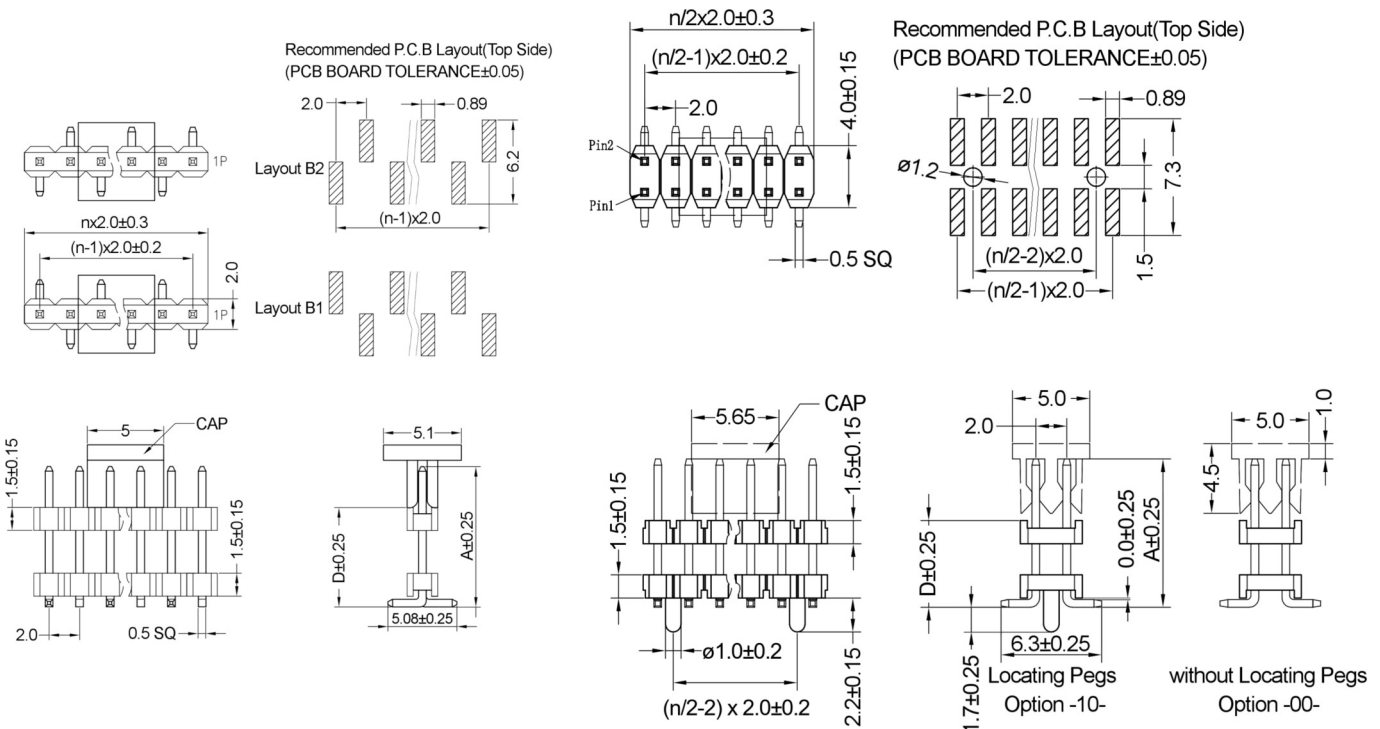
SMT-Sandwich-Stiftleisten RM 2,00mm, 1-/2-reihig  
SMT Dual Body Pin Headers, 2.00mm Pitch, Single/Double Row

## Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung <i>Copper alloy</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Au über Ni <i>Au over Ni</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500 V AC/DC
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1,5 A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40 °C ... +105 °C
Verarbeitung	230 °C für 30-60 Sekunden (260 °C für 10 Sekunden)
<i>Processing</i>	230 °C for 30-60 seconds (260 °C for 10 seconds)



Passende Buchsenleisten:  
*Compatible Female Headers:*  
**46-7450 46-7451 46-4160** etc.  
Weitere siehe Kapitel B  
*Please see ch. B for more*



Series	Contacts*	Rows*	Dimensions*	Dim.*	Plating	Locating Pegs*	Packaging*
<b>46-7352</b>	<b>30</b>	<b>11</b>	<b>01</b>	<b>6,35</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>PPST</b>
	03-30 Einreihig <i>Single row</i> 04-60 Zweireihig <i>Double row</i>	11 Layout B1 12 Layout B2 20 Zweireihig <i>Double row</i>	01 A=10,70mm 02 A=7,85mm 03 A=11,86mm 04 A=12,37mm 05 A=15,37mm 06 A=17,35mm 07 A=9,86mm 99- Kundenspez. <i>Customer-spec.</i>	D- [in mm]	00 Vergoldet <i>Gold plated</i>	00 Ohne Pos.hilfen <i>W/o loc. pegs</i> 10 Mit Pos.hilfen <i>(nur 2-reihig)</i> <i>With loc. pegs</i> <i>(double row only)</i>	ST PPST PPTR

### Lieferformen / Packaging Options:

**ST** In Stangen ohne Pick&Place-Pads / *In tubes w/o Pick&Place-Pads*  
**PPST** In Stangen mit P&P-Pads / *In tubes with P&P-Pads*  
**PPTR** Tape & Reel mit P&P-Pads / *Tape & Reel with P&P-Pads*

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** -  
please replace by your specifications.

# Reflow-Lötverfahren

## Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150 °C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	untere Temperaturangabe [°C]
Verweildauer oberhalb $T_L$	laut Angabe im Datenblatt [sec]
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur $T_P$	obere Temperaturangabe [°C]
Dauer Höchsttemperatur	laut Angabe im Datenblatt [sec]
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur $T_P$	max. 8m

### Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150 °C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature $T_L$	Lower Temperature [°C]
Duration above $T_L$	Acc. to datasheet [sec]
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature $T_P$	Upper Temperature [°C]
Duration Peak Temperature	Acc. to datasheet [sec]
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	max. 8min

